

PCB 焊接	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
工艺要求	直流伺服	MGRD-T-I_V2	焊接	QM033201104	V2	1/1	20201104

焊接基本要求

1) ~~×~~ 顶层不焊接元件 (见下图 1)

Q1 (FZT603) 1 个, D1 (US1D) , C6 (102/16V 0603) , R1 (1K 0603) , R2 (5.1K 0603)

底层全部焊接

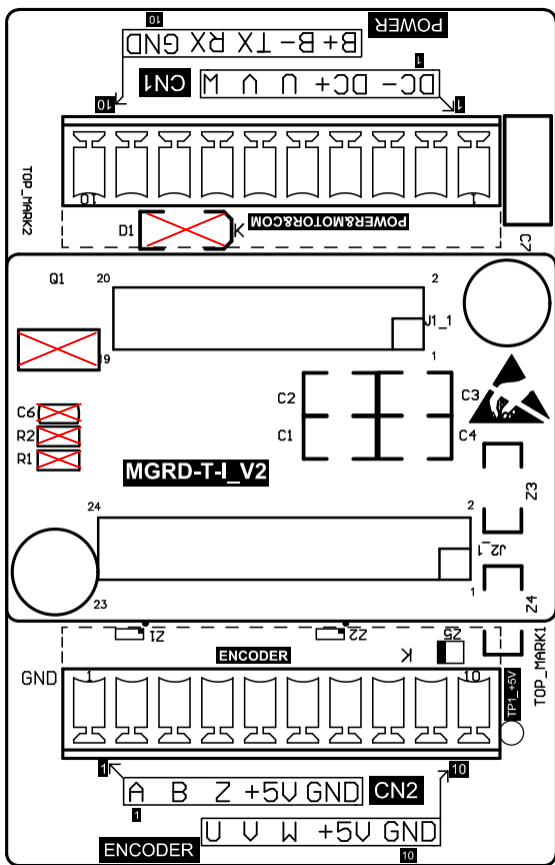


图 1

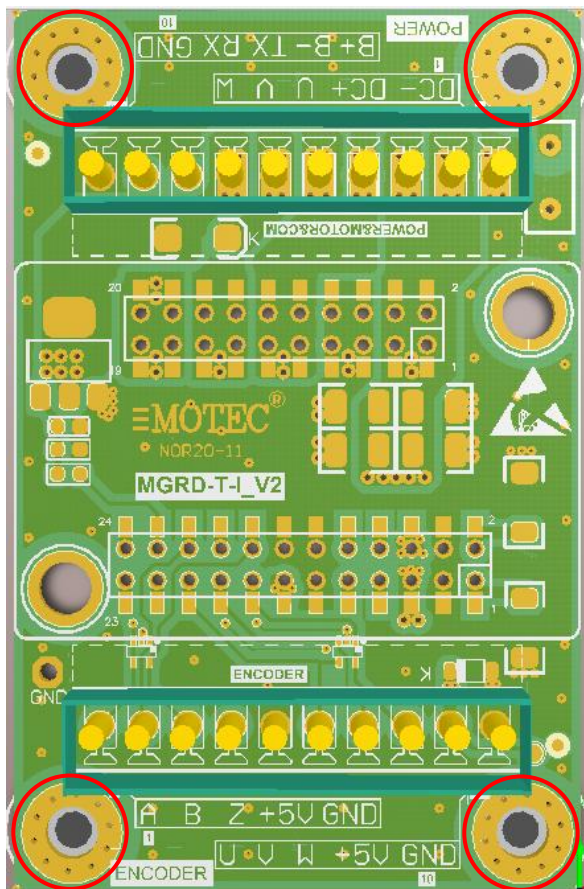


图 2

- 2) 下图红圈标识 LH1~LH4 底层贴片螺母焊接后, 其焊锡填满过孔, 但不能超出顶层平面 (见上图 2);
- 3) LH1, LH3 元件为 SMTWE3340MTJ (中通不带螺纹), LH2, LH4 元件为 SMTS03040MTS (带螺纹);
- 4) 注意 Z1, Z2 元件的焊接, 不接受空焊;
- 5) 所有端口插座焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 6) 所有极性元件, 严禁方向反;
- 7) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;
- 8) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;
- 9) 手工操作要做防静电处理;
- 10) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	